

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

(江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号)

创业板公开发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告



二零一九年三月

一、募集资金使用计划

公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），扣除发行费用后，将剩余资金全部用于“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目”。募集资金使用的具体计划如下表所示：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额（万元）
1	应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目	36,270.00	28,000.00
合计		36,270.00	28,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目

1、项目概况

本项目实施主体为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”或“公司”）。

新莱应材拟投资36,270.00万元，在新莱应材厂区建设新生产线。项目主要内容为购置先进生产设备及配套设备、改造厂房及建设自动化仓储等，最终建成年产158.4万件应用于半导体行业超高洁净管阀件生产基地。

2、项目必要性分析

（1）国家政策支持

集成电路¹制造水平是一个国家科技实力的重要体现，是信息化社会的基础

¹半导体是指介于导体与绝缘体之间的物理材料。半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于计算机、通信、消费电子、汽车、工业/医疗、军事/政府等核心领域。半导体主要由四个部分组成：集成电路，

行业之一，更对国家安全有着举足轻重的战略意义。近年来，国家各部门相继推出了一系列政策鼓励和支持集成电路行业发展。2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》，明确提出将核心电子器件、高端通用芯片及基础软件作为 16 个重大专项之一。2014 年 6 月，工信部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出“到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%，企业可持续发展能力大幅增强。”2016 年 10 月，工信部为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造 2025》等文件精神，正式发布《产业技术创新能力发展规划(2016-2020 年)》。该规划明确要求着力提升集成电路设计水平，发展高端芯片，不断丰富知识产权 IP 核和设计工具，推动先进制造和特色制造工艺发展，提升封装测试产业的发展水平，形成关键制造装备和关键材料供货能力，加紧布局超越摩尔相关领域。

面对“集成电路国产化”的急迫需求，现阶段的我国半导体行业在政府多项支持政策、国家“大基金”及地方产业基金的有力推动下，积极增强核心技术储备，加强产学研合作，加速对关键技术的掌握和研究成果的投产，现已在设计、制造及封测等领域培育出了一批表现优异的本土企业，初步建立起了比较完备的半导体产业链。

(2) 半导体行业市场上行，半导体设备行业顺势而起

半导体设备位于半导体产业的上游，随着下游集成电路设计、制造和封测的飙升，晶圆制造厂、封测厂赚取大量利润的同时纷纷增加资本开支，购买半导体设备、扩充产能、研发新工艺，半导体设备行业顺势而起。

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计数据，2018 半导体市场全年总销售额达到 4,688 亿美元，较 2017 年增长 13.7%。美国半导体市场总销售值约 1,030 亿美元，较 2017 年增长 16.4%；日本半导体市场销售值约 400 亿美元，较 2017 年增长 9.2%；欧洲半导体市场销售值达 430 亿美元，较 2017 年增长 12.1%；亚洲区半导体市场销售值约 2,829 亿美元，较 2017 年增长 13.7%；其中，中国大陆市场销售值约 1,584 亿美元，较 2017 年增长 6.1%。

光电器件，分立器件，传感器，其中集成电路占比在 80%以上，因此通常将半导体和集成电路等价。

受“中国 2025 制造”、“互联网+”等新世纪发展战略的带动、相关利好政策的推动以及外资企业加大在华投资的影响，我国集成电路行业迎来快速发展时期。根据中国半导体行业协会统计，2018 年中国集成电路产业销售额达到 6,532 亿元，同比增长 20.7%。其中，设计业销售额为 2,519.3 亿元，同比增长 21.5%；制造业销售额为 1,818.2 亿元，继续保持快速增长，同比增长 25.6%；封装测试业销售额 2,193.9 亿元，同比增长 16.1%。

由于市场对集成电路的需求缺口尚未完全补上，且我国持续投入资金建设晶圆厂，发展集成电路制造产业，2019 年，半导体设备市场有望继续保持高景气度。

（3）符合公司业务发展战略，有利于提升核心竞争力

随着半导体产业的快速发展，国内外各大厂商均加大对半导体行业的投资力度。在新产品及新技术不断出现的竞争环境下，如果技术研发和市场开拓不能快速响应，公司业务发展将受到影响。受益于国家产业政策支持，半导体行业相关市场将迎来爆发式增长，给公司带来了新的业务增长机会。本次发行募集资金将主要应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目，旨在进一步提升公司半导体行业超高洁净管阀件项目的技术水平及生产工艺，扩大产品产能，拓展公司在半导体行业超高洁净管阀件领域的市场份额，提升公司的核心竞争力。

（4）有利于提升公司盈利能力

本次募集资金投资项目的建成一方面有利于提升产品附加值，提高企业的盈利能力；另一方面有助于提升公司的品牌价值，建立品牌优势，提升公司半导体行业超高洁净产品的市场占有率和市场认可度。

（5）优化公司资本结构

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的资产规模将得到大幅增长；可转换公司债券转股后，将降低公司资产负债率，有利于公司保持合理的财务结构。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。募投项目的顺利实施，将使本次募集资金得到有效使用，进而增强公司的盈利能力，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司持续、稳定发展。

3、项目可行性分析

（1）集成电路产业重心转移带来巨大机遇

随着世界经济的复苏和世界半导体市场的增长，我国已经成为全球最大的电子产品制造基地，也是全球最大的半导体消费市场。中国半导体市场地位的逐年提升，国内政策与资金环境的不断改善都促使着全球产业重心一步步向我国倾斜。同时，旺盛的市场需求环境下，技术与资金的加速转移也为我国集成电路产业带来了新的发展机遇。

（2）下游制造业升级

随着《中国制造 2025》、“互联网+”行动指导意见等一系列国家战略的持续深入实施，下游制造业的升级换代进程加快，其中汽车电子、工业控制、消费电子等集成电路应用的重要领域维持较快增速。下游市场处于平稳发展的态势，直接影响集成电路产业链的持续扩张，有利于维持集成电路制造行业需求端的规模增长。

（3）新兴市场孕育机会

在即将到来的物联网和人工智能时代，创新科技产品的诞生将给集成电路制造行业带来新的机会。目前，物联网、5G、医疗、人工智能等新兴产业将成为行业新的市场推动力，未来科技发展的大趋势主要包括人工智能、机器学习、大数据、机器人和自动驾驶等技术的发展，这些大趋势的实现都需要芯片作为基础。广阔的市场空间给行业带来了新的发展机遇，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内集成电路制造公司将会出现发展的新契机。

（4）我国半导体设备洁净应用材料技术起步晚，市场缺口巨大

近年来，国内外半导体产业大量投资建厂，厂房设施中的气、液体供给系统所使用的超洁净阀、管件及腔体等半导体设备洁净应用材料的市场需求量迅猛提升。除此之外，目前半导体产品价格竞争激烈，国内厂商为降低生产成本，已逐渐采用国产的应用材料，然而其关键零组件仍从国外进口。

在半导体制程上使用的材料大都具有高度的毒性、腐蚀性、可燃性及爆炸性，而且是交互使用，极具危险性，其流量控制的精确度以及对洁净度的要求很高。我国半导体产业起步较晚，高端半导体设备应用的洁净材料几乎为国外厂商所垄断。目前面临低生产成本及快速维修的挑战下，半导体设备应用的洁净材料的本土化已为时势所趋，且该应用材料在半导体产业生产设施中，具有使用量大，汰

换率高及市场庞大潜力等商机。

(5) 公司将加速拓展半导体高洁净及超高洁净关键部件市场

据全球半导体装备行业协会(SEMI)预计,2017~2020年间,全球投产的有62座晶圆厂,其中26座布局在大陆,占全球总数的42%。未来数年间国内投入集成电路制造领域的资金将超过3,500亿元,公司将瞄准半导体市场全球转移机会与结构性变化,尤其是内地半导体产业的本土化趋势,充分整合公司技术和资本上的优势,围绕晶圆制造设备供给环节,专注于自主研发自有品牌的超洁净管道、管件、阀门等关键部件,实现高洁净半导体市场的全球化产业布局。未来几年,我国半导体市场前景良好,这将助推公司加速拓展半导体项目和超高洁净管道、管件、阀门等关键部件市场。

(6) 公司具有良好的技术及产业基础

公司已经具备了较强的自主创新研发能力,通过一系列研发项目的实施,将应用于半导体行业的超高洁净管阀件的技术水平与国际主流大厂进一步拉近。此外,公司在发展过程中十分重视对技术人才的培养和激励,其通过合作、交流和学习等方式为不同岗位的人员提供良好的专业技术培训,并通过股权激励的方式鼓励关键人才积极投身技术研发,与公司共同成长,成功打造了集成电路装备领域的人才高地。

(7) 公司有优质的客户基础

在半导体行业,企业产品主要服务于设备端和厂务端。在设备端,新莱应材与世界知名半导体设备厂商以及与国内知名半导体设备厂商开展合作如应用材料、拉姆研究、北方华创、中微半导体等;在厂务端,新莱应材面对终端客户,如台积电、厦门联芯、英特尔、三星、长江存储、华星光电、惠科等,并配合工程厂商如亚翔集成、至纯科技、中电四、正帆科技等,满足众多消费者的需求。

4、项目投资概算

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额
1	工程费用	28,654.80	28,000.00
1.1	装饰装修工程费用	2,864.30	
1.2	设备购置	23,417.70	
1.3.	安装费用	1,858.50	

1.4	配套公用工程	514.20	
2	工程建设其他费用	601.80	-
3	预备费	1,462.40	-
4	流动资金	5,551.00	-
5	总投资	36,270.00	28,000.00

注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入造成的差异。

5、项目实施进度

本项目建设期为 18 个月，包括前期工作、装饰装修工程、设备采购、设备安装、调试、人员培训、试生产、投产验收等过程。

6、项目选址

项目选址在新莱应材厂区在建 A#厂房，位于江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号。

7、项目审批情况

2019 年 1 月 23 日，昆山市经济和信息化委员会出具了《登记信息单》（项目代码：2019-320583-34-03-603936），对本项目进行了备案。

目前，新莱应材正在针对该募投项目申请环评批复，该工作尚未完成。

8、经济效益分析

本项目建设期为 18 个月，建成投产后预计首年可达到设计产能的 30%，建成投产后预计次年可达到设计产能的 75%，以后各年预计可达到设计产能的 100%，完全达产后预计每年可实现年销售收入 2.9 亿元，净利润 0.56 亿元，静态投资回收期约为 6.56 年（含建设期），预期经济效益良好。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司的主营业务为生产和销售自主研发的洁净不锈钢集成系统关键部件，并广泛应用于食品行业、生物医药行业、真空与电子半导体行业等，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，符合国家相关的产业政策以及公司的战略发展规划，与行业发展趋势相吻合。“应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线

技改项目”将通过引进先进生产设备、自动仓储技术等，推动公司实现制造升级和工业升级，打造核心自主品牌，提升公司产品在半导体领域的市场份额。借助本次募投项目的实施，公司将实现制造生产能力升级，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。本次发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司负债规模将逐步下降，净资产规模将逐步上升，资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。由于募集资金投资项目经济效益的释放需要一定的时间，本次发行后，若投资者迅速行使转股权利，可能导致公司在短期内存在每股收益及净资产收益率较上年同期下降的风险；但长期来看，随着公司资金实力和经济效益的增强，未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升，最终为公司和投资者带来较好的投资回报。

四、可行性分析结论

综上所述，本次公开发行可转换公司债券是公司紧抓市场发展机遇，扩大核心业务优势，增强竞争力，实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过本次募投项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

董事会

2019年3月19日